

Compression Molding System

Model CPM2250

Coming soon

**Compression molding system
for large size PLP molding to meet industry needs**



業界ニーズに応える大判PLP成形を実現する コンプレッションモールド装置

- 大判パネル最大625mm×620mmの自動成形が可能
- 高出力プレスにより狭ギャップMUF対応
- 液状樹脂およびフルモールドに対応
- 大判サイズに最適な成形技術を採用
- 独自のキャビティダウン方式を採用し、高品質な成形を実現
- 顆粒樹脂の均一な散布により安定した成形が可能
- プレスモジュールの増減による生産数量の変化への対応

Coming soon

SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
モデル		—	CPM2250			
装置区分		—	Manual	Semi-Auto	Full-Auto	
ワークタイプ		—	パネル・ウェハ			
ワークサイズ	パネル	mm	625 × 620 (Max.)			
	ウェハ	mm	φ 450 (Max.)	—	—	
樹脂		—	顆粒・液状			
マシンタイム		sec	—	—	Approximately 75	
外形寸法	プレス数	module	1	1	1	2
	幅	mm	2,680	4,395	6,035	7,685
	奥行き	mm	2,670	2,670	3,750	3,750
	高さ	mm	2,310	2,310	2,310	2,310
重量		ton	14.8	19.7	22.2	35.0
成形取り数		workpiece	1	1	1	2
マガジンスペース		—	—	—	FOUP Input/Output stage : 1 cassette each In/Out stage : Panel 1 by 1	
クランプ出力		kN/(tf)	49.0—2,451.0/5.0—250.0			
クランプ速度		mm/sec	70 (Max.)			
品種切替え方式		—	—	キット交換式		
リリースフィルム幅		mm	740 (Max.)			

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。
- ・外形寸法は顆粒樹脂仕様のもを記載しています。

TOWA株式会社

【本社・工場】

〒601-8105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町5番地

【海外販売拠点】

■中国

- ・TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
- ・Hechuang Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.

■台湾

- ・TOWA Taiwan Co., Ltd.

■韓国

- ・TOWA Korea Co., Ltd.

■シンガポール

- ・TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

■マレーシア

- ・TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

■タイ

- ・TOWA THAI COMPANY LIMITED

■フィリピン

- ・TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.

■インド

- ・TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

■ドイツ

- ・TOWA Europe GmbH

■オランダ

- ・TOWA Europe B.V.

■アメリカ

- ・TOWA USA Corporation

